



ARM[®] Clúster Supercomputer

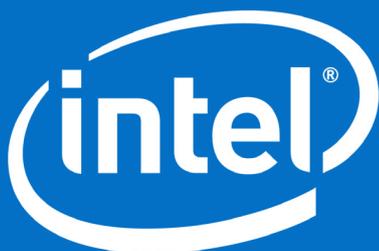
El Clúster HPC ARM[®] está diseñado para ofrecer la mayor variedad de configuraciones posibles.

Al ofrecer plataformas de servicio y computación altamente escalables y modulares, se basa en las últimas tecnologías de procesamiento y aceleración x86 de Intel[®], AMD[®] y NVIDIA[®]. Los nodos y componentes de servidor estándar de la industria se han optimizado para computación de alto

rendimiento (HPC) y se han integrado estrechamente con una pila de software de HPC integral, creando un sistema unificado que sobresale en capacidad y en cargas de trabajo con gran cantidad de datos.

El sistema de rack está integrado por SIASA[®] y para ofrecer el máximo rendimiento de computación acelerado en la gama más amplia de HPC.

Conozca



Intel®, líder en la industria de los semiconductores, está configurando el futuro centrado en los datos con la tecnología informática y de comunicaciones, que es la base de las innovaciones mundiales.

La experiencia en ingeniería de la compañía está ayudando a enfrentar los desafíos más grandes del mundo, así como también a asegurar, alimentar y conectar miles de millones de dispositivos y la infraestructura del mundo conectado e inteligente, desde la nube a la red, al borde y todo lo que se encuentre en el medio.



Los procesadores **Intel® Xeon® Gold 6200** y los procesadores **Intel® Xeon® Platinum 8200** están diseñados para las cargas de trabajo más exigentes de HPC y AI. Estos procesadores escalables **Intel® Xeon®**, disponibles en los **Supercomputadoras ARM®**, brindan a los clientes de **SIASA®** una opción poderosa y flexible para personalizar sus sistemas de supercomputación, y acelerar la incorporación de metodologías de IA a las capacidades de simulación y modelado de HPC existentes.



Configuraciones FLEXIBLES y ESCALABLES

Los últimos procesadores **Intel® Xeon® Cascadelake** y **AMD® EPYC™** o los aceleradores **NVIDIA® Tesla® GPU**.

Plataformas para montaje en rack para una fácil configuración y escalado en niveles de nodo y de todo el sistema.

Computación acelerada con **NVIDIA® Tesla® GPUs**.

Sistemas de archivos paralelos de alto rendimiento basados en la solución **Lustre®**.

Diseños refrigerados por aire o líquido.

Múltiples opciones de interconexión, incluyendo **InfiniBand™** y **Ethernet**, ambos con diferentes velocidades de 200, 100 y 56Gbps; y **Intel® OmniPath** con velocidad de 100Gbps.

EFICIENCIA y CONFIABILIDAD incorporadas



Fuentes de alimentación de equilibrio de carga de alta eficiencia.



Opción para los intercambiadores de calor y enfriadores de la puerta trasera de la rejilla de enfriamiento por líquido para un mayor ahorro de energía.



Energía redundante, subsistemas de gestión y redes con capacidades de conmutación por error.



Componentes críticos fácilmente accesibles e intercambiables en caliente.



Múltiples niveles de redundancia y tolerancia a fallos.

Integral. Adaptable. 100% Personalizable



Compatible con la mayoría de los compiladores, depuradores, programadores y bibliotecas.



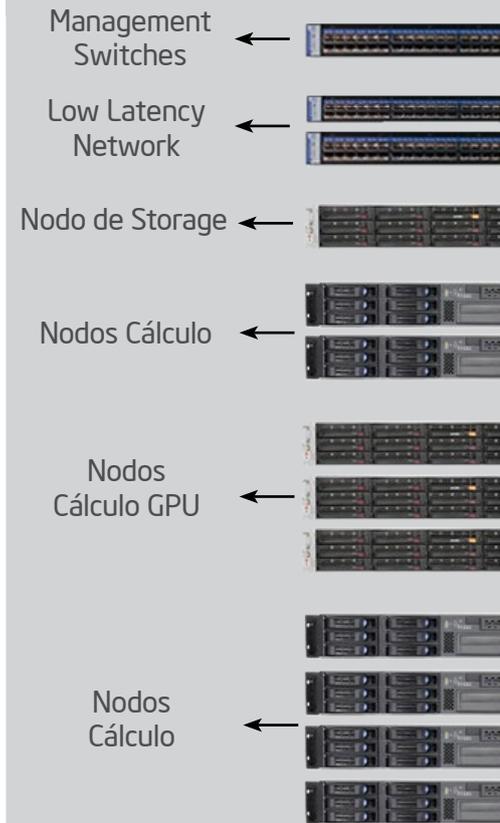
Bright Cluster Manager para HPC (opción para la gestión del sistema).



Integrado y probado.

Especificaciones Técnicas

	ARM® CLUSTER GENERACIÓN 8	ARM® CLUSTER GENERACIÓN 7
PROCESADORES	2x Procesadores Intel® Xeon® Scalable	4U: Familia de Procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v4 1U: Procesadores Dual Intel® Xeon® Scalable
MEMORIA	Hasta 6 TB DDR4 (16 x 128 GB DIMMs)	4U: Hasta 3 TB DDR4 (24 x 128 GB DIMMs) 1U: Hasta 1.5 TB DDR4 (12 x 128 GB DIMMs) ECC 2,466 MHz
ACELERADORES	NVIDIA® Tesla® V100, P40 ó P100 PCIe GPU aceleradores ó Nallatech FPGA aceleradores; soporta hasta 10 400W partes ó 8 450W partes	4U: Hasta 8 NVIDIA Tesla V100 ó P100 SXM2 GPU aceleradores; soporta hasta 300W partes 1U: Hasta 4 NVIDIA Tesla V100 GPU aceleradores; optimizado para GPUDirect RDMA
DRIVE BAYS	Configuración de almacenamiento local múltiple opciones 12 unidades de 2,5" intercambiables en caliente (hasta a 4 NVMe); algunas configuraciones requieren un adicional controlador de almacenamiento adicional. El número total de los variadores varían según la configuración	4U: 16 hot-swappable 2.5" drives (hasta 8 NVMe) 1U: 2 HS 2.5" NVME drive bays; 4 total 2.5" HDD bays 4x16
SLOTS DE EXPANSION	Ranuras PCIe 3.0 x 16 que admiten múltiples Topologías PCIe y opciones de configuración	4U: 4 x 16, perfil bajo (bandeja GPU), 2 x 8 (bandeja de placa base) PCIe 3.0 1U: 2x16 (FHFL / LP) de PLX; 2x16 (FHFL / LP) desde UPC
FUENTE DE ALIMENTACION	Cuatro fuentes de alimentación de CA de 2200W; Redundancia N + 1 y N + N (limitada a configuraciones específicas)	4U: Four 2200W AC power supplies; 2+2 redundancy; titanium-level efficiency 1U: Fuente de alimentación redundante 2000W Titanium
ENTRADA DE ALIMENTACION	200-277VAC, 10A max	200-277VAC, 10A max
TEMPERATURA	Operando: 10°C-35°C, ASHRAE 2	Operando: 10°C-35°C, ASHRAE 2



Certificaciones y Premios



Nuestras Alianzas



Estados Unidos
250 Catalonia Ave Ste 600 | Miami
+1.305.4289659

www.armcorp.net